1	ASER	RFA	M M	ACH	INF
1	ASER.	DEA	IAI IAI		

Patent Number:

JP8118056

Publication date:

1996-05-14

Inventor(s):

HORIGUCHI YUKIHIRO

Applicant(s):

AIDA ENG LTD

Requested Patent:

☐ JP8118056

Application Number: JP19940254898 19941020

Priority Number(s):

IPC Classification:

B23K26/06; B23K26/04

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To provide a safe and easy-to-operate laser beam machine which is capable of greatly expanding the adjustable range of an incident angle while miniaturizing a damper and also enables a three-dimensional scanning operation or a continuous operation.

CONSTITUTION: This machine is structured such that a laser machining nozzle 10 and a damper 30 are connected so that the reflected laser beam Bo may be received by a photodetector surface 31 and a specified relative positional relation may be maintained, even in the case where an incident angle &theta i of a laser beam Bi on the machining surface 1 varies within a prescribed range, and that the damper 30 can be forcedly cooled by the use of a cooling fluid.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-118056

(43)公開日 平成8年(1996)5月14日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

技術表示箇所

B 2 3 K 26/06

A A

26/04

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平6-254898

(22)出顧日

平成6年(1994)10月20日

(71)出廣人 000100861

アイダエンジニアリング株式会社神奈川県相模原市大山町2番10号

(72)発明者 堀口 幸弘

神奈川県相模原市東橋本3-5-21 明和

ハウス304

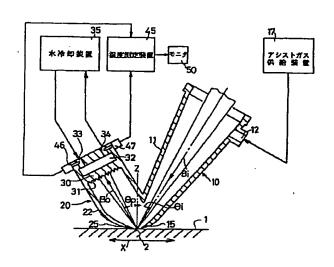
(74)代理人 弁理士 長島 悦夫

(54) 【発明の名称】 レーザ加工装置

(57)【要約】

【目的】ダンバーの小型化を図りつつ入射角の調整可能 範囲を大幅に拡大できかつ三次元的走査運転や連続運転 も可能とする安全で取扱容易なレーザ加工装置を提供する。

【構成】本装置は、レーザ加工用ノズル10とダンバー30とをレーザビームBiの加工面1に対する入射角 θ iが所定範囲内で変化した場合でも当該ダンバー30の受光面31で当該レーザ反射光Boを受光可能かつ一定の相対位置関係を保持可能に連結し、かつ当該ダンバー30を冷却流体を用いて強制冷却可能に構成されている。



1 加工所 10 レーザ加工用ノズル 80 ゲンバー 81 安米市 B1 レーザピーム 91 入納角 B0 レーザ沢州光

【特許請求の範囲】

【請求項1】 加工面に入射角をもってレーザビームを 照射するレーザ加工用ノズルと、加工面から反射された レーザ反射光を吸収減衰するダンパーとを具備するレー ザ加工装置において、

前記レーザ加工用ノズルと前記ダンバーとを、前記レーザピームの加工面に対する入射角が所定範囲内で変化した場合でも当該ダンバーの受光面で当該レーザ反射光を受光可能かつ一定の相対位置関係を保持可能に連結し、かつ当該ダンバーを冷却流体を用いて強制冷却可能に形 10成した、ことを特徴とするレーザ加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、加工面に入射角を持ってレーザピームを照射するレーザ加工用ノズルと、加工面から反射されたレーザ反射光を吸収減衰するダンパーとを具備するレーザ加工装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図4において、レーザ加工用ノズル10は、レーザ発振器から発生されたレーザピームBiを、加工面1に入射角 θ iを持って照射しつつ当該加工面1を加工(例えば、レーザ焼き入れ)する。また、アシストガス供給装置17から供給されたアシストガスも、レーザ照射点2に向けて噴流する。ダンバー30は、加工面1から反射されたレーザ反射光Boをレーザ吸収剤がコーティングされた受光面31で受けて吸収減衰するもので、反射角 θ o(入射角 θ i)に対応させた位置に固定配設されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、レーザ加工 30 態様の多様化の要請、例えばある入射角を設定して三次 元的曲面をレーザ焼入れするといった加工に伴うレーザ ビームBiの入射角θiの調整範囲の拡大や複雑な三次 元加工を行いたいとの要請を、かかる従来装置(10, 30)では満すことができない。

【0004】すなわち、ダンパー30は、レーザ照射点 2を通る垂直軸線 2 に対する固定的な入射角 θ i (反射角 θ o) に対応させて固定配設されている。したがって、この前提をなす入射角 θ i が調整変化されると、レーザ反射光 B o がダンパー30の受光面31から外れて 40 しまうので、レーザ反射光 B o を吸収できなくなる。また、三次元加工は加工面1を走査することで可能であるが、加工物を複雑に動かす必要があるため非現実的である。そこで、レーザビーム B i を走査すると、とたんにレーザ反射光 B o がダンパー30の受光面31から大きく外れてしまい一層吸収できなくなってしまう。この吸収できなくなってしまう現象をを回避するには、ダンパー30を大型化するかレーザビーム B i の入射角 θ i や走査方向 B に合わせて移動させなければならない。しかし、これらの方法は、装置全体の大型化とコスト高、そ 50

してレイアウトの自由度の制限を受け現実的ではない。 【0005】本発明の目的は、ダンパーの小型化を図り つつ入射角の調整可能範囲を大幅に拡大でき、かつ三次 元的な走査運転や連続運転も可能とする安全で、取扱容 易なレーザ加工装置を提供するととにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、レーザビームの入射角が変化しても、当該レーザ反射光とダンバーの受光面との相対位置関係を一定の範囲内に保持可能で三次元的走査運転を可能にし、かつダンバーの小型化を図りつつ強制冷却の導入によって連続運転を可能に構成し、前記課題を解消するものである。

【0007】詳しくは、本発明に係るレーザ加工装置は、加工面に入射角をもってレーザビームを照射するレーザ加工用ノズルと、加工面から反射されたレーザ反射光を吸収減衰するダンバーとを具備するレーザ加工装置において、前記レーザ加工用ノズルと前記ダンバーとを、前記レーザビームの加工面に対する入射角が所定範囲内で変化した場合でも当該ダンバーの受光面で当該レーザ反射光を受光可能かつ一定の相対位置関係を保持可能に連結し、かつ当該ダンバーを冷却流体を用いて強制冷却可能に形成した、ことを特徴とする。

[0008]

【作用】上記構成による本発明の場合、レーザ加工用ノズルとダンパーとが、レーザピームの加工面に対する入射角が一定範囲内で調整変化された場合でも、当該レーザ反射光を受光面で受光可能に連結されているので、レーザ加工態様を拡大でき、かつレーザ加工用ノズルとダンパーとの水平方向の相対位置関係が一定であるから、走査運転も可能となり取扱いも非常に容易である。

[0009]また、ダンバーが小型であっても、冷却流体を用いて強制冷却されるので、連続運転やレーザビームのパワーの増大によるレーザ加工態様の拡大が図れ、かつ装置全体を小型にできる。

[0010]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明 する。

(第1実施例)本レーザ加工装置は、図1に示す如く、レーザ加工用ノズル10とダンバー30とを相対位置関係が一定となるように連結するとともに、ダンパー30を冷却流体(水)で強制冷却可能に構成されている。

【0011】レーザ加工用ノズル10のケーシング11 とダンバー30を保持するケーシング20とは、一体形成されるとともに、常態において直垂軸線Zに対するレーザビームBiの入射角 θ iとレーザ反射光Boの反射角 θ oとが等しく、かつ反射角 θ oをもって反射されるレーザ反射光Boがダンバー30の受光面31の中央部に入射されるように構成してある。

【0012】したがって、レーザビームBiの入射角 iを調整変化させても、レーザ加工用ノズル10とダン バー30との水平方向の相対位置関係が不変であるか ら、レーザ反射光Boが受光面31から外れてしまうと とがなく、入射角θ i の調整に際する取扱いも簡単であ る。また、レーザビームBiをX方向に走査した運転が できる。図には示されていないが、レーザビームBiの 入射角 Biが所定範囲内に保った他方向の走査も可能で ある.

【0013】また、ケーシング20にガイド部22が設 けられているので、入射角θiを大きく変化させてもレ ーザ反射光Boが外に漏れなく、ガイド部22の先端2 5がレーザ加工用ノズル10のケーシング11の先端1 5と合わせられているので、アシストガスによるシール ド効果を一段と向上させることができる。なお、アシス トガスには、アシストガス供給装置17から供給口12 を通して供給される。

【0014】さて、ダンパー30とケーシング20と は、一体に形成されており、かつ受光面31は凹凸形状 とされレーザ反射光Boを多重反射させて減衰すること ができる。また、受光面31には、レーザ光吸収剤がコ 面31の上方内部には冷却室(クーラ)32が設けられ ているので、ダンパー30の発熱を防止できるから、レ ーザ反射光Boの吸収減衰を連続して良好に保てるとと もに、レーザ加工の連続運転が可能となる。

【0015】なお、この冷却室32には、水冷却装置3 5からの冷水が入口33を通して供給されかつ出口34 を通して排出される。したがって、ダンパー30を高効 率で強制冷却できる。

【0016】また、との実施例では、ダンパー30のエ ネルギー吸収状況を把握可能な温度測定装置45とモニ タ50とが設けられている。すなわち、温度測定装置4 5は、入口33に取付けられた温度検出センサ(例え ば、サーミスタ、サーモカップル)46と、出口34に 取付けられた温度検出センサ(例えば、サーミスタ、サ ーモカップル) 47とから、冷水の入口温度Tiと出口 温度Toとを測定するとともに、その温度差△T(=T i-To)を求めモニタ50に表示可能に形成されてい

【0017】なお、温度測定装置45またはモニタ50 に、温度差△Tにエネルギー換算定数を乗算して吸収エ 40 ネルギー量を求める換算機能を設け、この吸収エネルギ ー量をもモニタ50に表示可能に形成することができ る。とのようにすれば、一段とレーザ照射点2のエネル ギー状態を簡単に把握できるので、加工品質管理を容易 化できかつ加工品質を大幅に向上でき得る。

【0018】しかして、との第1実施例によれば、レー ザ加工用ノズル10とダンパー30とをレーザビームB iの加工面1に対する入射角 fiが所定範囲内で変化し た場合でも当該ダンパー30の受光面31で当該レーザ 反射光Boを受光可能かつ一定の相対位置関係を保持可 50 【0027】しかして、この第2実施例によれば、第1

能に連結し、かつ当該ダンパー30を冷却流体を用いて 強制冷却可能に構成されているので、ダンパー30の小 型化とレーザビームBiのパワーアップとを図りつつ、 入射角θiの調整可能範囲を大幅に拡大できるとともに 三次元的走査運転も可能で安全、かつ取扱いが極めて容 易である。

【0019】また、レーザ加工用ノズル10とダンパー 30とが、両ケーシング11,20を介して一体に形成 されているので、両者10、30の相対位置関係を一段 と確実に一定化保持できる。したがって、入射角 θ iを 調整変化させたり走査運転をする際の取扱いが一段と容 易である。

【0020】また、ケーシング11,20の各先端1 5, 25がレーザ照射点2を覆うように形成されている ので、アシストガスによるシールド効果を一段と向上で き、かつアシストガスの消費量を大幅に削減できコスト 的にも有利である。

【0021】また、ダンパー30と一体でかつその上方 内部に冷却室32が設けられているので、受光面31を ーティングされているので、吸収減衰する。また、受光 | 20 高能率で冷却できる。つまり、レーザ反射光Boの吸収 能率を最高的に、かつ安定して保持できる。

> 【0022】また、受光面31がレーザ吸収剤でコーテ ィングされるとともに凸凹形状とされているので、吸収 減衰と多重反射減衰とにより、レーザ反射光Boを高能 率で減衰させられるから、一段とレーザビームBiのパ ワーアップを図った各種レーザ加工が可能である。

【0023】さらに、温度測定装置45とモニタ50と を設け、冷却室32への冷水出入口温度Ti, Toを検 出しつつレーザ照射点2のエネルギー状況を簡単に把握 30 できるように形成されているので、レーザ加工品質管理 を容易に行えかつ品質を大幅に向上できる。

【0024】(第2実施例)第2実施例は、図2に示さ れる。この実施例の基本的構造(10,20,30等) は、第1実施例(図1)の場合と同様とされているが、 さらに、ケーシング20のガイド部22の内面21をレ ーザ反射光Boの有効反射面として利用し、レーザビー $\Delta B i O$ 入射角 θi を大きく変化させても、レーザ反射 光Boがより確実に受光面31に到達可能に構成してあ る。

【0025】また、有効反射面(内面21)にもレーザ 吸収剤をコーティングしてレーザ反射光Boの吸収減衰 を促進可能に形成してある。したがって、受光面31の 実質的受光面積を拡大できる。

【0026】さらに、この有効反射面(21)が設けら れているので、ケーシング20と一体のダンパー30等 をレーザ照射点2に垂直な軸線2上に配設できる。よっ て、水平方向Xの寸法をより狭小化し大幅な小型化を図 れるとともに、入射角 f i の調整可能範囲を著しく拡大 できかつ取扱いが一段と容易となる。

実施例の場合と同様な作用効果を奏することができる 他、さらに、入射角 f i の調整可能範囲の拡大化、小型 化、取扱容易化等を大幅に向上させることができる。

【0028】(第3実施例) この第3実施例は、第2実 施例が特に入射角 & i の調整範囲が大きな場合に有用に 構築されているのに対して、レーザ照射点2の近傍に大 きな空間を形成しノズル先端15が干渉し易い加工面 (物) 1 にも適用可能に構成したものである。

【0029】図3において、レーザ加工用ノズル10と ダンパー30とを、リンク機構(ピン18, 第1リンク 10 15 先端 19、ピン38、第2リンク39)で、相対位置関係不 変に連結してある。この応用として、図示していないが レーザ加工用ノズル10とダンパー30の相対位置関係 を、入射角 θ i と反射角 θ oが等しくなるように、自動 的に設定できる駆動機構を付加することにより操作性向 上に役立てるととも考えられる。

[0030]かくして、との第3実施例によれば、第1 実施例の場合と同様な作用効果を奏することができる 他、さらに、各種各様の加工物(面)1に干渉なく適用 でき、かつ構造簡単で低コストである。

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、レーザ加工用ノズルと ダンバーとをレーザビームの加工面に対する入射角が所 定範囲内で変化した場合でも当該ダンパーの受光面で当 該レーザ反射光を受光可能かつ一定の相対位置関係を保 持可能に連結し、かつ当該ダンバーを冷却流体を用いて 強制冷却可能に構成されているので、ダンバーの小型化 を図りつつ入射角の調整可能範囲を大幅に拡大できると ともに三次元的走査運転や連続運転も可能で安全かつ取 扱いが極めて容易である。

【図面の簡単な説明】

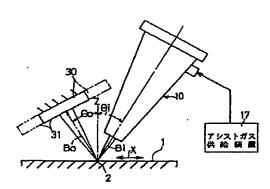
【図1】本発明の第1実施例を示す全体構成図である。*

- *【図2】第2実施例を示す全体構成図である。
 - 【図3】第3実施例を示す全体構成図である。
 - 【図4】従来例を説明するための図である。

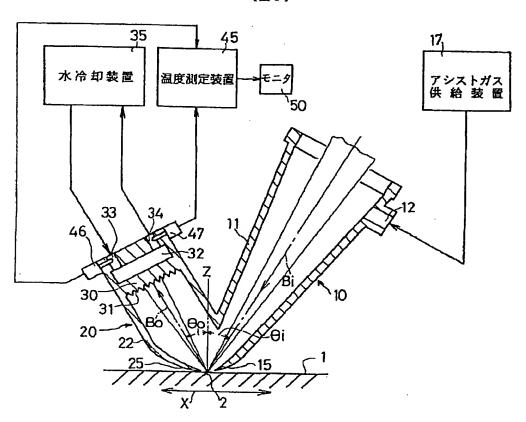
【符号の説明】

- 加工面 1
- レーザ照射点 2
- 10 レーザ加工用ノズル
- 11 ケーシング
- 12 供給口
- - 17 アシストガス供給装置
 - 18 ピン
 - 19 第1リンク
 - 20 ケーシング
 - 21 内面
 - 22 ガイド部
 - 25 先端
 - 30 ダンパー
 - 31 受光面
- 20 3 2 冷却室
 - 33 入口
 - 34 出口
 - 35 水冷却装置
 - 38 ピン
 - 39 第2リンク
 - 45 温度測定装置
 - 46,47 温度検出センサ
 - 50 モニタ
 - Bi レーザビーム
- 30 θ i 入射角
 - Bo レーザ反射光
 - θο 反射角

[図4]



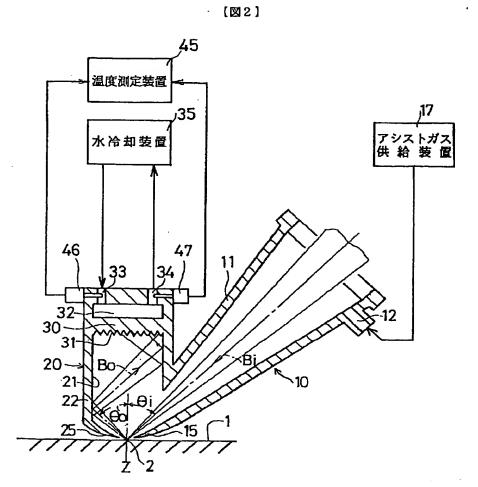
[図1]



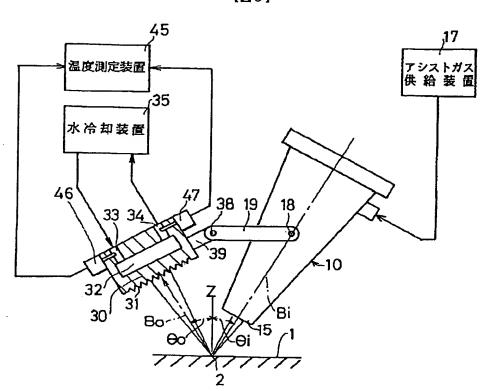
加工面 レーザ加工用ノズル ダンパー

受光面 レーザピーム

入射角 レーザ反射光



[図3]



Entgegenhaltung 5:

Pat.-Offenlegungsschrift Nr. 8-118056 vom 14. 5. 1996

Anmeldung Nr. 6-254898 vom 20. 10. 1994

Verbandspriorität: ohne

Anmelder: Aida Engineering K. K., Kanagawa, JP

Titel: Laserbearbeitungseinrichtung

[0010]

[Ausführungsbeispiele]

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

Die vorliegende Laserbearbeitungseinrichtung wird so ausgebildet, daß eine Laserbearbeitungsdüse 10 und ein Dämpfer 30 miteinander so verbunden werden, daß ihre relative Ortsbeziehung konstant ist, wie dies in Fig. 1 gezeigt ist. Der Dämpfer 30 ist mit einer Kühlflüssigkeit (Wasser) zwangsläufig abkühlbar.

[0011]

Ein Gehäuse 11 der Laserbearbeitungsdüse 10 und ein Gehäuse 20 zum Halten des Dämpfers 30 werden miteinander einteilig und so ausgebildet, daß im normalen Zustand ein Eintritts-

winkel $\theta_{\rm i}$ eines Laserstrahls $\rm B_{i}$ zu einer vertikalen Achse Z gleich mit einem Reflexionswinkel $\theta_{\rm O}$ eines Reflexionslaserstrahls $\rm B_{\rm O}$ ist, und daß der um den Reflexionswinkel $\theta_{\rm O}$ reflektierte Reflexionslaserstrahl $\rm B_{\rm O}$ in die Mitte einer optischen Empfangsfläche 31 des Dämpfers 31 eintritt.

[0012]

Auch wenn daher der Eintrittswinkel θ_i des Laserstrahls B_i geregelt und verändert wird, bleibt die relative Ortsbeziehung zwischen der Laserbearbeitungsdüse 10 und dem Dämpfer 30 in horizontaler Richtung unverändert, so daß der Reflexionslaserstrahl B_0 nicht von der optischen Empfangsfläche 31 abweicht. Auch die Behandlung bei der Regelung des Eintrittswinkels θ_i ist leicht. Ferner ist der Betrieb mit der Abtastung des Laserstrahls B_i in X-Richtung möglich. Auch die Abtastung in anderer Richtung ist möglich, wobei der Eintrittswinkel θ_i des Laserstrahls B_i stets innerhalb eines vorgegebenen Bereichs gehalten wird, obwohl dies nicht dargestellt wird.

[0013]

Da ferner das Gehäuse 20 ein Führungsteil 22 aufweist, entweicht der Reflexionslaserstrahl $B_{\rm O}$ auch bei einer großen Veränderung des Eintrittswinkels $\theta_{\rm i}$ nicht nach außen, wobei sich das vordere Ende 25 des Führungsteils 22 und das vordere Ende 15 des Gehäuses 11 der Laserbearbeitungsdüse 10 ange-

messen gegenüberliegen, so daß die Abschirmwirkung durch Arbeitsgas wesentlich erhöht werden kann. Außerdem wird das Arbeitsgas von einer Arbeitsgasversorgungseinrichtung 17 über eine Versorgungsöffnung 12 versorgt.

[0014]

Der Dämpfer 30 und das Gehäuse 20 sind miteinander einteilig ausgebildet, wobei die optische Empfangsfläche 31 uneben ausgebildet ist, wodurch der Reflexionslaserstrahl mehrfach reflektiert und gedämpft werden kann, Ferner ist die optische Empfangsfläche 31 mit einem Laserstrahlenabsorptionsmittel beschichtet, durch das der Laserstrahl absorbiert und gedämpft wird. Da ferner im Innenteil oberhalb der optischen Empfangsfläche 31 eine Kühlkammer (Abkühler) 32 vorgesehen ist, die eine Erwärmung des Dämpfers verhindert, ist eine kontinuierliche Laserbearbeitung durch die kontinuierliche Absorption und Dämpfung des Reflexionslaserstrahls Bo möglich.

[0015]

Das Kühlwasser einer Wasserabkühleinrichtung 35 wird über einen Eingang 33 in die Kühlkammer 32 eingelassen und über einen Ausgang 34 hieraus abgelassen. Der Dämpfer 30 kann daher mit hoher Effizienz zwangsläufig abgekühlt werden.

[0016]

Bei diesem Ausführungsbeispiel werden ferner eine Temperaturmeßeinrichtung 45 und ein Monitor 52 vorgesehen, durch die ein Energieabsorptionszustand des Dämpfers 30 detektiert werden kann. D. h. die Temperaturmeßeinrichtung 45 mißt eine Eingangstemperatur T_i und eine Ausgangstemperatur T_0 des Kaltwassers mittels eines an dem Eingang 33 angebrachten Temperatursensors (z. B. eines Thermistors, eines Thermoelementes) 46 und eines an dem Ausgang 34 angebrachten Temperatursensors (z. B. eines Thermistors, eines Thermoelementes) 47 und ermittelt eine Temperaturdifferenz ΔT (= T_i – T_0), die in einem Monitor 50 angezeigt wird.

(First exemplary embodiment)

The present laser processing device is designed such that a laser processing tip 10 and a damper 30 are connected with one another such that their relative spatial relationship is constant, as this is shown in Fig. 1. The damper 30 can be necessarily cooled with a coolant fluid (water).

[0011].

A housing 11 of the laser processing tip 10 and a housing 20 to hold the damper 30 are designed as one piece with one another and such that, in the normal state, an entrance angle θ_i of a laser beam B_i relative to a vertical axis Z is equal to a reflection angle θ_0 of a reflection laser beam B_0 , and that the reflection laser beam B_0 reflected by the reflection angle θ_0 arrives in the center of an optical reception surface 31 of the damper 31 [sic].

[0012]

Therefore, even when the entrance angle θ_i of the laser beam B_i is regulated and varied, the relative spatial relationship between the laser processing tip 10 and the damper 30 remains unchanged in the horizontal direction, such that the reflection laser beam B_0 does not deviate from the optical reception surface 31. The treatment is also easy in the regulation of the entrance angle θ_i . The operation with the scanning of the laser beam B_i in the x-direction is also possible. The scanning in another direction is also possible, whereby the entrance angle θ_i of the laser beam B_i is always kept within a predetermined range (although this is not shown).

[0013]

Since the housing 20 also comprises a guide part 22, even given a large change of the entrance angle θ_i the reflection laser beam B_0 does not escape outwards, whereby the front end 25 of the guide part 22 and the front end 15 of the housing 11 of the laser processing tip 10 suitably face one another, such that the shielding effect can be significantly increased by operating gas. Moreover, the operating gas is supplied via a supply opening 12 by an operating gas supply device 17.

The damper 30 and the housing 20 are designed with one another as a single part, whereby the optical reception surface 31 is designed uneven, whereby the reflection laser beam B₀ reflects multiple times and can be damped. The optical reception surface 31 is also coated with a laser beam absorption means via which the laser beam is absorbed and damped. Since a cooling chamber (cooler) 32 that prevents a heating of the damper 30 is also provided in the inner part above the optical reception surface 31, a continuous laser processing is possible due to the continuous absorption and damping of the reflection laser beam B₀.

[0015]

The cooling water of a water cooling device 35 is let into the cooling chamber 32 via an input 33 and let out of this via an output 34. The damper 30 can therefore be necessarily cooled with high efficiency.

[0016]

A temperature measurement device 45 and a monitor 52 are also provided in this exemplary embodiment, via which an energy absorption state of the damper 30 can be detected. This means that the temperature measurement device 45 measures an input temperature T_i and an output temperature T_0 of the cold water by means of a temperature sensor (for example a thermistor, a thermoelement) 46 mounted at the input 33 and a temperature sensor (for example a thermistor, a thermoelement) 47 mounted at the output 34 and determines a temperature difference ΔT (= $T_i - T_0$) that is displayed on a monitor 50.

.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.